

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-18

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（网络会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	鹏扬基金、信达澳亚、宝盈基金、（因采取网络会议形式，参会者未签署书面调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。）
时间	2024年8月23日 14:00-17:00
地点	广州广合科技股份有限公司会议室
公司接待人员	副总经理、董事会秘书：曾杨清 证券事务代表：陈炜亮、黄淑芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2024年上半年经营情况：</p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入约170,558.35万元，同比增长45.50%，实现归属于上市公司股东的净利润31,938.71万元，同比增长102.42%。</p> <p>2024年第二季度，公司实现营业收入约92,122.60万元，环比增长17.45%，实现归属于上市公司股东净利润17,430.10万元，环比增长20.14%。驱动公司营收利润增长的主要因素还是通用服务器的迭代升级以及AI类产品需求增长。</p>

2024 年上半年，公司 EGS 平台服务器产品出货占比继续提升，BHS 和 Turin 平台以及交换机产品完成小批量出货，同时公司启动了 PCIE6.0 服务器 PCB（Oak 平台和 Venice 平台）样品的试制。全面参与客户 UBB、I/O 等 AI 产品的量产项目，报告期内公司加大了 PCIe 交换板和 OAM 板的开发力度，进一步提升高端产品占比。在产能建设方面，公司积极推动广州一厂 HDI 能力提升，以应对当前的 BMC 及加速卡的需求。同时为加大海外市场开拓力度，满足海外客户全球供应链调整的需求，公司泰国生产基地建设按计划快速推进，预计明年一季度实现规模量产。

二、产能建设情况：

在产能建设方面，公司重点推动泰国广合的建设，目前各项进度按计划推进，预计 2025 年一季度量产。广州一厂持续技改，打通瓶颈工序产能，提升工艺能力，同时推动 HDI 能力提升，以应对当前的 BMC 及加速卡、switch、光模块、存储等产品的需求。

三、公司泰国基地定位及产能情况：

为加大海外市场开拓力度，满足海外客户需求，泰国工厂产品定位依然是数据通讯产品，建成投产后将与广州工厂形成协同效应，一期工程设计满产年销售约 20 亿元。

四、公司广州工厂二季度稼动率的情况：

广州工厂通过持续对关键工序进行技术改造，以达

到提升工艺能力和瓶颈工序产能的目标，就第二季度的稼动率持续保持在较高的水平。

五、上半年原材料价格波动及对公司的影响：

受大宗商品价格上升影响，二季度部分材料价格有所上升，但目前对公司影响较小，公司会密切关注大宗商品价格的未来走势，并通过内部降本增效、优化产品结构等手段来降低原材料成本上升对经营的影响。同时公司也会密切上下游供应商、客户的沟通与协作，以降低原材料价格波动对经营的影响。

六、汇率波动对公司的影响：

公司上半年外销收入占比超过七成，汇率波动对公司经营影响较大，公司根据销售及外汇回款情况，参考汇率市场走势有进行滚动锁汇操作，尽可能平滑汇率波动对公司经营的影响。

七、公司与客户的研发合作机制：

公司一方面基于芯片发展技术进行专项材料和技术预研，另一方面根据客户需求组织技术团队进行定制化工艺及产品研发，并开展技术成果的总结和转化，持续开展技术改造和升级，确保公司产品研发的迭代始终与客户产品迭代保持同步。同时根据客户要求新产品功能和性能的全方位验证，并对成熟产品的生产过程质量监控及

	<p>可靠性监控提供能力支持，为高端印制线路板的产品品质提供技术保证。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024年8月23日